

2025 年上半年中国半导体行业投融资情况分析报告



Manufacturing Intelligence Resource

2025-08

并购家 免费行业报告网

IPOIPO.CN 每日更新 不用注册会员 无广告 永久免费

目录

Part I 项目介绍	5
A. 研究方法.....	5
B. 项目定义	5
B-1. 行业定义.....	5
B-2. 地域定义.....	6
Part II 2025 年上半年半导体行业市场规模情况	7
A. 全球半导体行业市场规模分析	7
A-1. 2020H1-2025H1 全球半导体市场规模	7
B. 亚太半导体行业市场规模	8
B-1. 2020H1-2025H1 亚太半导体市场规模.....	8
Part III 中国半导体行业投资情况.....	10
A. 2025 年上半年中国半导体行业市场投资规模分析	10
A-1. 2020H1-2025H1 中国半导体行业投资市场规模.....	10
B. 2025 年上半年中国半导体行业投资项目分布情况	11
B-1. 2025 年 1-6 月中国半导体行业各领域投资占比.....	11
B-2. 2025 年上半年半导体投资地域分布	13
Part IV 2025 年上半年中国半导体行业融资全景分析	15
A. 2025 年 Q1 半导体融资情况	15
A-1. 2025 年 Q1 半导体行业融资列表	16
B. 2025 年 Q2 半导体融资情况	25

B-1. 2025 年 Q2 半导体行业融资列表.....	26
C. 2025 年上半年中国半导体企业上市动态梳理	38
附录：MIR 睿工业服务体系	40
定制化业务.....	40
标准化业务.....	40
媒体业务	40

图表

图 1：2020H1-2025H1 全球半导体市场规模（亿美元）	7
图 2：2020H1-2025H1 亚太半导体行业市场规模（亿美元）	8
图 3：2020H1-2025H1 中国半导体行业投资市场规模（亿美元）	10
图 4：2025 年 1-6 月中国半导体行业细分领域投资占比	11
表 1：2025 年 1-6 月中国半导体投资地域分布特征.....	13
表 2：2025 年 1-3 月半导体行业融资交易金额.....	15
表 3：2025 年 1-3 月半导体行业融资交易轮次	15
表 4：2025 年 1-3 月半导体行业融资交易地区分布.....	15
表 5：2025 年 1-3 月半导体行业融资动态	17
表 6：2025 年 4-6 月半导体行业融资交易金额.....	25
表 7：2025 年 4-6 月半导体行业融资交易轮次	25
表 8：2025 年 4-6 月半导体行业融资交易地区分布.....	26
表 9：2025 年 4-6 月半导体行业融资动态	27
表 10：2025 年上半年中国半导体企业上市动态	38

Part I 项目介绍

A. 研究方法

睿工业本次的半导体投融资分析报告，采用严谨的项目管理机制和专业的市场调研方法，通过产品、厂商、设备制造商这些市场参与者的研究，结合我们多年的行业积累，给出了我们对半导体行业相关的独到见解，涵盖半导体行业基本知识、投融资情况等内容。

B. 项目定义

B-1. 行业定义

半导体行业产业链呈现高度专业化分工特征，从上游到下游可清晰划分为原材料、半导体设备、芯片设计、晶圆制造、封装测试五大核心环节。

原材料：原材料是半导体制造的起点，其纯度、稳定性与一致性直接决定芯片的精度上限、长期性能与运行可靠性，核心品类普遍具备“高技术壁垒、高纯度要求（部分需达到 99.9999999% 以上，即 9 个 9）、高定制化”特征，核心品类包括：硅材料、特种气体、湿电子化学品、光刻胶等。

半导体设备：半导体设备是支撑原材料加工、晶圆制造、封装测试等全流程的核心工具，是半导体行业技术壁垒最高、研发周期最长（通常 5-10 年）、资本投入最大的环节，其性能直接决定芯片的制程精度与生产良率，按应用环节可分为五大核心品类：光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备、离子注入设备、量测设备等。

芯片设计：芯片设计是决定芯片核心功能定位、性能表现上限与成本控制空间的关键前置环节。其核心逻辑清晰明确：首先基于具体应用场景需求（如消费电子、汽车电子等领域），确定芯片的功能边界与性能指标；随后围绕需求搭建电路架构，完成晶体管级别的电路设计与模块集成；最终输出标准化的物理版图文件，为后续晶圆制造环节提供精准的生产依据。

核心流程围绕“需求→设计→验证→量产”闭环展开。

晶圆制造：晶圆制造是将芯片设计方案转化为实际物理电路的核心生产环节，技术复杂度极高——需在直径 8-12 英寸的硅晶圆上，通过数十甚至上百道精密工序（如光刻、刻蚀、沉积、注入）逐层构建电路，制程精度以“纳米（nm）”为单位。

封装测试：封装测试是半导体产品出厂前的最后关键环节，分为“封装”与“测试”两大模块，核心作用是保护芯片、实现电气连接、筛选合格产品，直接影响芯片的可靠性、散热性能与应用适配性。

B-2. 地域定义

本次调研的范围以中国大陆（东北地区、华北地区、华东地区、华南地区以及西部地区）为核心，同时包含中国台湾地区，全面覆盖中国半导体相关产业重点区域。

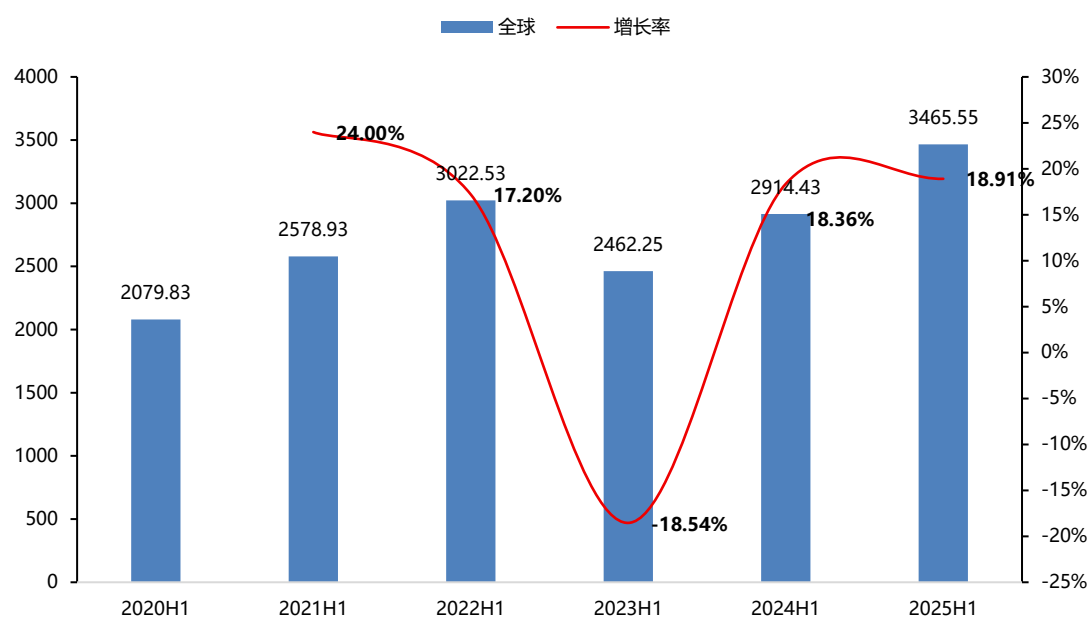
区域	省份
东北	黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古
华北	新疆、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、河北、山东、北京、天津
华东	江苏、安徽、浙江、湖南、湖北、上海
华南	江西、广东、广西、海南、福建
西部	西藏、青海、四川、重庆、贵州、云南

Part II 2025 年上半年半导体行业市场规模情况

A. 全球半导体行业市场规模分析

A-1. 2020H1-2025H1 全球半导体市场规模

图 1: 2020H1-2025H1 全球半导体市场规模 (亿美元)



数据来源: 世界半导体贸易统计组织 (WSTS) MIR DATABANK 整理 www.mirdatabank.com

2020 - 2025 年 H1 期间, 全球半导体市场规模走势跌宕起伏、呈现出复杂的变化趋势。

2021H1: 较 2020H1 实现显著增长, 增长率达 24.00%, 市场规模从 2079.83 亿美元升至 2578.93 亿美元, 受益于下游电子消费、科技产业等快速发展, 带动半导体市场扩容

2022H1: 延续增长, 以 17.20% 增长率使规模达 3022.53 亿美元, 虽增速较 2021H1 有所放缓, 但仍保持向上趋势, 行业发展惯性及新兴应用 (如新能源汽车半导体需求增长) 等因素持续发挥作用。

2023H1: 该年度市场规模降至 2462.25 亿美元, 增长率为 -18.54%, 出现明显下滑, 受多重因素影响, 如全球经济环境波动导致下游需求收缩 (消费电子市场疲软, 手机、PC 等产品出货量下降。), 同时半导体供应链问题 (如地缘政治引发的供应受限、库存调整等。) 也对市场规模产生冲击, 使得行业进入短期调整期。

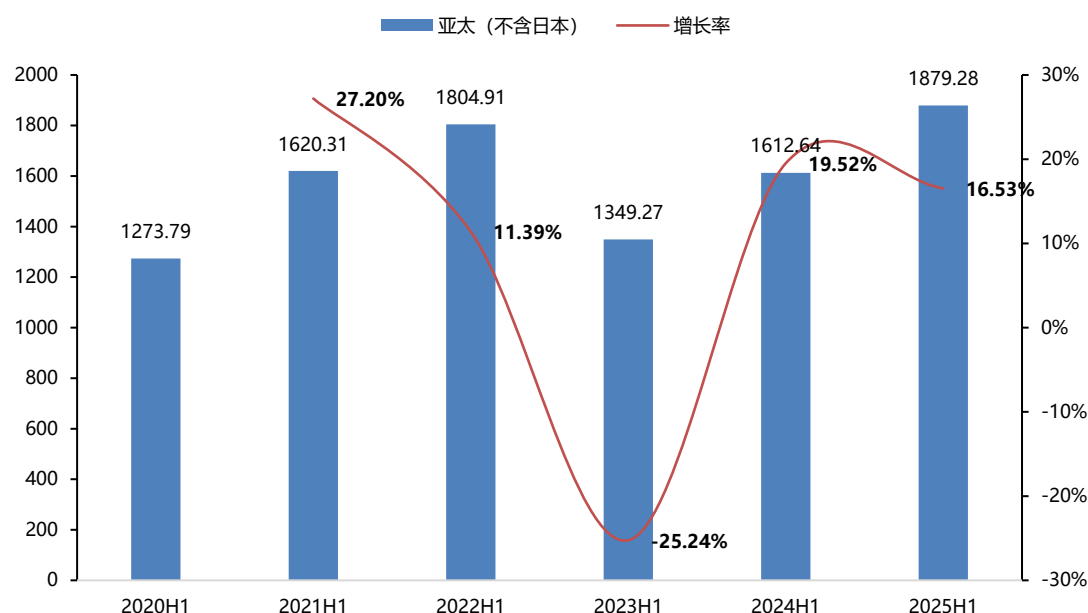
2024H1: 在 2023H1 下滑后恢复增长, 增长率 18.36%, 规模至 2914.43 亿美元, 市场需求重新激活 (如人工智能相关硬件对半导体需求拉动。) 等促使市场回暖。

2025H1: 全球半导体市场强劲复苏, 规模达 3465.55 亿美元, 增长率 18.91%。驱动力来自 AI 算力芯片 (GPU、TPU 需求激增。) 与存储芯片 (DRAM、HBM 表现超预期。

B. 亚太半导体行业市场规模

B-1. 2020H1-2025H1 亚太半导体市场规模

图 2: 2020H1-2025H1 亚太半导体行业市场规模 (亿美元)



数据来源: 世界半导体贸易统计组织 (WSTS) MIR DATABANK 整理 www.mirdatabank.com

2020H1-2025H1 中国半导体市场虽经历短期波动, 但长期增长逻辑未变, 国产替代、AI、新能源汽车等需求仍为核心驱动力。

2021H1: 市场规模跃升至 1620.31 亿美元, 增长 27.20% 受益于全球科技产业复苏, 消费电子、新能源汽车等下游需求爆发, 带动半导体采购量激增, 成为增长核心驱动力。

2022H1: 延续增长至 1804.91 亿美元, 但增速收窄至 11.39%。行业发展惯性仍在, 不过全球供应链摩擦加剧 (如物流成本上升、芯片制造环节受限), 开始抑制增长动能, 为后续调整埋下伏笔。

2023H1: 市场规模骤降至 1349.27 亿美元, -25.24% 的跌幅创阶段新低, 多重利空集中爆发: 全球经济衰退预期下, 消费电子市场需求坍塌 (手机、PC 出货量大幅下滑。); 叠加半导体行业库存去化周期, 企业主动削减采购, 供需关系剧烈反转, 市场进入 “寒冬期”。

2024H1: 规模反弹至 1612.64 亿美元, 19.52% 增速宣告市场回暖。人工智能硬件加速落地 (如 AI 服务器、智能终端扩容。), 拉动半导体需求; 同时供应链逐步修复, 企业补库存周期开启, 推动市场复苏。

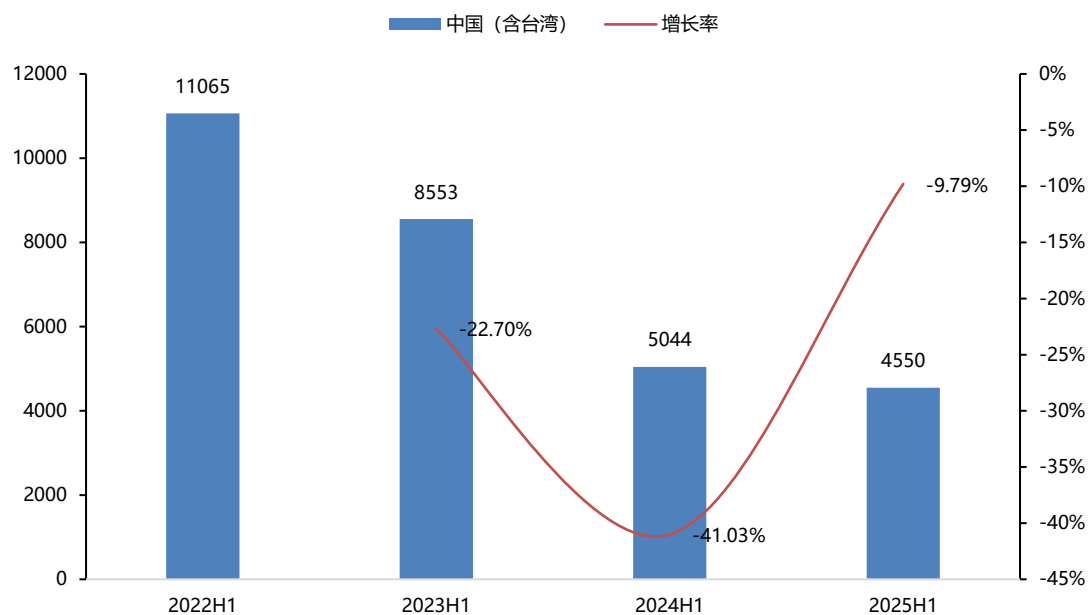
2025H1: 进一步回升至 1879.28 亿美元, 16.53% 增速延续复苏趋势。AI 算力芯片、汽车电子等新兴需求持续释放, 叠加本土半导体制造能力提升 (如晶圆厂扩产、技术突破。), 支撑市场规模再创新高。

Part III 中国半导体行业投资情况

A. 2025 年上半年中国半导体行业市场投资规模分析

A-1. 2020H1-2025H1 中国半导体行业投资市场规模

图 3：2020H1-2025H1 中国半导体行业投资市场规模（亿美元）



数据来源：CINNO Research MIR DATABANK 整理 www.mirdatabank.com

2022 - 2025 年上半年，中国（含台湾）半导体投资规模呈现连续下滑轨迹，但不同阶段降幅特征有别。

2023 年投资额同比下滑 22.7%，主要源于国际贸易保护主义倾向增加，全球半导体行业生产和供应链面临的不确定性增大。同时，半导体市场需求波动、价格水平不稳定、产业分化割裂等问题也对行业投资产生影响

2024 年投资降幅扩大至 41.03%，源于全球需求疲软、技术壁垒与国际供应链重组等多重因素集中冲击。终端市场消费电子、存储芯片等领域还没从低谷里走出来，企业盈利不太轻松，面临不少压力，叠加外部环境对投资信心的压制，使得投资规模加速下滑

2025 年上半年中国半导体产业（含台湾）总投资额约为 4550 亿元人民币，同比下降 9.8%。这一降幅较 2024 年同期的 41.03% 显著收窄，反映出全球半导体行业周期性调整正逐步趋稳。



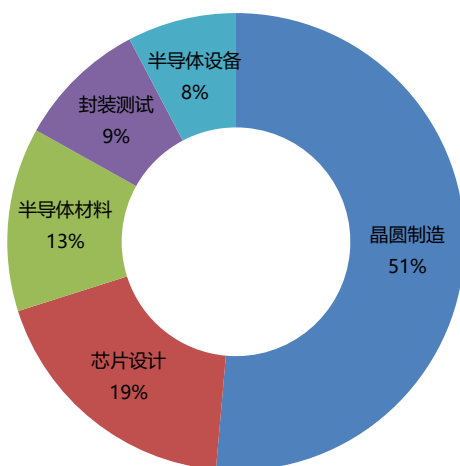
本轮投资收缩主要受终端市场需求疲软及全球半导体库存调整影响，自 2024 年起，消费电子、存储芯片等领域持续处于底部磨合阶段，部分企业盈利质量承压。然而，资本开支的推进节奏，已出现边际改善的迹象，资金仍主要流向晶圆厂扩产、设备采购以及材料类项目，显示产业链对中长期市场信心。

B. 2025 年上半年中国半导体行业投资项目分布情况

B-1. 2025 年 1-6 月中国半导体行业各领域投资占比

图 4：2025 年 1-6 月中国半导体行业细分领域投资占比

■ 晶圆制造 ■ 芯片设计 ■ 半导体材料 ■ 封装测试 ■ 半导体设备



数据来源：CINNO Research MIR DATABANK 整理 www.mirdatabank.com

从各细分领域投资分布来看，不同领域呈现差异化发展态势，既有传统核心领域的规模支撑，也有新兴领域的亮眼表现，产业投资结构正逐步向高端化、特色化调整。

各细分领域投资情况

晶圆制造：作为半导体产业的核心环节，晶圆制造依旧占据投资主导地位，投资规模达 2340 亿元，占总投资的 51.4%，表明成熟制程投资趋于饱和，近年来，随着国内晶圆制造产能的逐步提升，部分成熟制程的市场竞争加剧，企业在该领域的投资更为谨慎。



半导体材料：半导体材料领域获得 593 亿元投资，占总投资的 13.0%，投资结构的持续优化成为最大亮点——高端材料领域占比显著提升，尤其以第三代半导体材料（SiC/GaN）和电子特气为代表的细分赛道，已成为产业投资的核心发力点。

第三代半导体材料（SiC/GaN）：以 162 亿元的投资规模位居半导体材料各细分领域榜首，占材料总投资的 27.3%。作为宽禁带半导体材料，其在耐高温、耐高压、高频特性等方面优势显著，可广泛应用于新能源汽车电控系统、5G 基站射频器件、智能电网等高端场景，有效满足下游产业对高性能半导体材料的需求，目前已成为国内半导体材料产业重点突破的方向之一。

电子特气：以 114 亿元投资规模位居第二，占材料总投资的 19.3%。高纯电子特气是晶圆制造过程中的关键耗材，直接影响芯片的良率与性能，其投资增长不仅反映出国内晶圆制造产能扩张带来的需求拉动，更体现出国内企业在半导体材料供应链关键环节的持续突破，有助于降低对进口电子特气的依赖，提升供应链自主可控能力。

两大高端领域投资合计占半导体材料总投资的比重接近 50%，这一数据清晰表明，中国半导体材料产业正加速从传统硅基材料向高端特色材料进行战略转型，逐步摆脱“中低端扎堆、高端依赖进口”的旧有格局。

芯片设计：投资 853 亿元，占比 18.7%，遭遇较大幅度调整，同比下滑 23.7%。这主要受消费电子需求疲软和国际供应链重组的直接影响。智能手机、平板电脑等消费电子产品市场增长乏力，导致芯片设计企业订单减少，投资意愿下降。

封装测试：封装测试领域本期投资 417 亿元，占总投资的 9.2%，其承压逻辑与芯片设计领域高度一致——同样受到消费电子需求疲软和国际供应链重组的双重冲击。

作为半导体产业链的后道环节，封装测试的业务量与前端芯片设计、晶圆制造的产能及下游终端需求直接挂钩。当前消费电子终端需求不足，芯片设计企业订单减少，晶圆制造产能利用率有所波动，均传导至封装测试环节，导致企业业务量下降，进而缩减投资规模。

半导体设备：在各细分领域普遍承压的情况下，半导体设备领域成为唯一实现投资正增长的板块，本期投资同比逆势增长 53.4%，表现尤为亮眼。这一增长态势主要源于两大核心驱动力：

国内产业需求拉动：随着国内晶圆制造、功率半导体等领域产能的持续扩张，以及半导体材料高端化转型对设备的配套需求，市场对半导体设备（如光刻设备、沉积设备、刻蚀设备等）的需求不断增加，形成刚性采购支撑；



国产设备技术突破：国内半导体设备企业在技术研发与市场拓展方面取得阶段性进展，部分设备已实现从“0 到 1”的突破，并逐步进入国内主流晶圆厂的供应链体系，产品竞争力与市场认可度显著提升，吸引了更多资本关注与投资注入。

B-2. 2025 年上半年半导体投资地域分布

表 1：2025 年 1-6 月中国半导体投资地域分布特征

排名	区域	投资占比
1	江苏省	20.70%
2	上海市	18.80%
3	浙江省	14.40%
4	北京市	12.50%
5	湖北省	12.50%
6	其他	21.1%
-	前五大区域合计	78.90%

数据来源：CINNO Research MIR DATABANK 整理 www.mirdatabank.com

在中国大陆 21 个省市（含直辖市）的半导体投资版图中，区域集中化特征尤为显著：前五大投资区域合计吸纳了近八成资金。

从具体分布来看，各核心区域的投资占比呈现梯度差异：江苏省以 20.7% 的占比位居全国首位，凭借完善的产业配套与成熟的制造基础，成为国内半导体投资的核心集聚区；上海市以 18.8% 的占比紧随其后，作为长三角半导体产业的“龙头城市”，持续发挥技术与资源枢纽作用；浙江省（14.4%）、北京市（12.5%）与湖北省（12.5%）分列三至五位，其中北京依托政策与人才优势巩固核心地位，浙江深度融入长三角产业协同，而湖北则凭借特色领域突破实现弯道超车，数据显示，这五大区域的投资占比合计高达 78.9%，直接主导了中国大陆半导体投资的整体布局。

长三角地区产业积淀深厚。江苏、上海、浙江所在的长三角板块，已形成覆盖晶圆制造、封装测试、设备材料等环节的完整半导体产业链，上下游企业密集、配套能力强，为投资落地提供了成熟的产业基础；

其二，核心城市政策资源倾斜明显。上海、北京等城市通过设立半导体专项投资基金、推出高端人才引进计划、搭建产业创新平台等举措，形成差异化制度优势，有效吸引资本与项目集聚；



值得关注的是，湖北省的“突围”成为本次投资分布的重要亮点。该省份并非传统半导体产业强省，却凭借在存储芯片领域的突破性发展——从技术研发到产能建设的快速推进，成功跻身投资前五，不仅打破了传统投资格局，更凸显出国内新兴半导体产业集群的崛起态势。



Part IV 2025 年上半年中国半导体行业融资全景分析

A. 2025 年 Q1 半导体融资情况

2025 年第一季度国内半导体行业融资活跃度保持高位，融资事件数量突破百起。从轮次分布看，融资主要集中于 B 轮及更早阶段，这一特征充分体现出资本市场对半导体领域初创企业的投资热情正持续升温。

从交易金额来看，本季度亿元级融资达 29 笔；千万元级融资 40 笔；另有 42 笔融资未对外披露具体金额，整体资金投向呈现“大额交易稳定、中小额交易活跃”的特点。

表 2：2025 年 1-3 月半导体行业融资交易金额

统计维度	具体分类	数量 / 笔数
按交易金额划分	亿元级融资	29
	千万元级融资	40
	未披露金额融资	42

数据来源：芯潮 IC MIR DATABANK 整理 www.mirdatabank.com

从交易轮次来看，主要集 A 轮、B 轮和 Pre-A 轮，分别有 24 笔、14 笔和 10 笔。

表 3：2025 年 1-3 月半导体行业融资交易轮次

统计维度	具体分类	数量 / 笔数
按交易轮次划分	A 轮	24
	B 轮	14
	Pre-A 轮	10

数据来源：芯潮 IC MIR DATABANK 整理 www.mirdatabank.com

从交易事件地域分布来看，本季度主要分布在江苏省、上海市和广东省，各自占比为 28.83%、21.62%和 11.71%。

表 4：2025 年 1-3 月半导体行业融资交易地区分布

地域	案例数 (起)	占比
江苏	32	28.83%
上海	24	21.62%
广东	13	11.71%
浙江	12	10.81%
北京	8	7.22%
山东	4	3.61%
湖南	3	2.70%



湖北	3	2.70%
陕西	3	2.70%
福建	2	1.80%
四川	2	1.80%
安徽	2	1.80%
重庆	1	0.90%
天津	1	0.90%
河南	1	0.90%

数据来源：芯潮 IC MIR DATABANK 整理 www.mirdatabank.com

A-1. 2025 年 Q1 半导体行业融资列表

从融资领域看，半导体设备领域成为本季度融资“高地”，昂坤视觉、众硅科技、精测半导体、魅杰光电、星空科技等企业获得资本青睐，反映出行业发展的几大趋势：

一方面，本土替代加速。在国际供应链不确定性增加背景下，国内晶圆厂持续扩产与技术迭代，对高端设备自主化的需求愈发迫切，资本积极加注设备企业，助力突破海外技术封锁，推动国产设备加速进入市场；另一方面，技术升级倒逼。像 Chiplet、先进封装等新兴技术的发展，对量检测、抛光、键合设备的精度提出了更高要求，设备企业需要大量资金投入研发以适配新需求，融资成为技术迭代的“输血”通道，支撑企业跟上技术升级节奏。

在设备领域，既有精测半导体、众硅科技等聚焦成熟制程设备（如前道量检测、CMP 抛光）的企业，也有昂坤视觉（光学检测）、星空科技（光刻机配套）等布局前沿技术的公司。这映射出当前资本策略：在成熟赛道聚焦“替代进度”，优先投资能快速实现国产替代、满足现有产线需求的企业，抢占当下市场空白；在创新领域则押注“技术潜力”，提前布局 Chiplet、先进封装等未来技术所需设备，以抢占产业升级的先机。

江苏、上海、广东等省市融资活跃，形成产业集群。以江苏为例，苏州、南京汇聚众多半导体设备、芯片设计企业，依托高校科研资源（如浙江大学、中科院在长三角的科研力量）、完善的产业链配套（材料、制造环节协同），构建起产业发展生态，吸引资本集聚。集群效应有效降低企业沟通成本，加速技术转化与产业协同，形成融资与产业发展相互促进的良性循环。



表 5：2025 年 1-3 月半导体行业融资动态

序号	日期	企业名称	融资轮次	融资金额	主要投资方	主营业务 & 产品	成立时间	省市
1	2025/1/2	瀚天天成	Pre-IPO 轮	未披露	金圆集团、工银资本	SiC 外延片生产	2011 年	福建 - 厦门
2	2025/1/2	百识电子	B 轮	数亿元	未披露	6 英寸碳化硅及 6、8 英寸硅基氮化镓外延代工服务	2019 年	江苏 - 南京
3	2025/1/2	创视半导体	A 轮	未披露	领投：尚顾资本、瀚联半导体产业基金、ARM 旗下安创基金、浙江大学教育基金	CMOS 图像传感器 (CIS) 芯片开发	2023 年	浙江 - 杭州
4	2025/1/2	伊世智能	A 轮	未披露	鲁信创投、重庆清研资本	控制器芯片级信息安全产品	2021 年	上海市
5	2025/1/3	江原科技	天使 + 轮	未披露	鼎晖百孚、龙芯创投、安博通、品高股份	AI 算力芯片	2022 年	广东 - 广州
6	2025/1/3	泰研半导体	B 轮	5000 万元	紫金港资本	Laser+Plasma+Sputter 成套复合工艺与制程应用设备	2017 年	广东 - 深圳
7	2025/1/6	合见工软	A 轮	近十亿元	浦东引领区基金	EDA	2020 年	上海市
8	2025/1/6	诺睿科半导体	Pre-A 轮	未披露	琢石投资	半导体前道量测设备	2022 年	上海市
9	2025/1/6	励兆科技	Pre-A++ 轮	数千万元	领投：金浦智能 跟投：临港科创投	综合性射频等离子系统	2022 年	上海市
10	2025/1/6	镭神泰克	A 轮	近亿元	达晨财智	半导体激光装备	2021 年	江苏 - 苏州
11	2025/1/7	中安半导体	C 轮	未披露	大基金二期、长存产业投资基金	半导体量测检测设备	2020 年	江苏 - 南京
12	2025/1/8	翠展微电子	B + 轮	数亿元	领投：国科长三角资本 跟投：同鑫资本、银茂控股	IGBT 模块	2018 年	上海市
13	2025/1/8	四维映射	Pre-A 轮	千万级	昕科基金	模拟 EDA	2022 年	浙江 - 杭州
14	2025/1/8	原位芯片	A + 轮	近千万美元	美元基金	MEMS 技术及产品	2015 年	江苏 - 苏州
15	2025/1/9	研微半导体	Pre-A++ 轮	未披露	华夏钜投、欣柯创投	半导体沉积设备	2022 年	江苏 - 无锡

16	2025/1/9	镭神技术	C 轮	未披露	中国国新控股	光通信半导体装备	2017 年	广东 - 深圳
17	2025/1/9	中科加禾	Pre-A1 轮	数千万元	领投：北京市人工智能产业投资基金	异构原生算力软件	2023 年	江苏 - 南京
18	2025/1/13	至讯创新	A 轮	亿元级	ISSI、择通投资	存储芯片	2021 年	江苏 - 无锡
19	2025/1/14	禾芯半导体	A + 轮	未披露	凯风创投、信科资本	Switch 芯片设计	2023 年	江苏 - 苏州
20	2025/1/14	星微科技	B + 轮	未披露	无锡集成电路产业专项母基金、南通新一代信息技术产业专项母基金、江苏有线旗下睿辉资本	精密运动控制	2015 年	江苏 - 无锡
21	2025/1/15	神州半导体	A 轮	未披露	大基金二期	半导体产线电源系统服务	2016 年	江苏 - 扬州
22	2025/1/15	环诚智能装备	A 轮	未披露	技转智石	半导体设备	2022 年	四川 - 成都
23	2025/1/15	为旌科技	B 轮	近亿元	深创投、临芯投资和明势资本	智能 SOC 芯片设计	2020 年	上海市
24	2025/1/15	盛方科技	A 轮	数千万元	弘晖基金	准分子激光器	2017 年	广东 - 深圳
25	2025/1/16	晶存科技	Pre-IPO 轮	未披露	领投：尚硕资本 跟投：容亿资本、合肥建投、兴证资本、赖山投资	存储芯片	2016 年	广东 - 深圳
26	2025/1/16	镭芯光电	C 轮	未披露	兰璞资本	半导体光电器件	2019 年	江苏 - 南京
27	2025/1/17	元视芯	A 轮	数亿元	领投：开源证券、西投控股 跟投：江诣创投、祥峰投资、GRC 富华资本、经发资产	智能传感技术	2021 年	广东 - 深圳
28	2025/1/19	芯晖装备	B 轮	亿元	领投：初芯基金 跟投：毅晟投资	半导体装备制造	2018 年	浙江 - 嘉兴
29	2025/1/20	奕行智能	A 轮	数亿元	领投：东方富海管理的国家中小企业发展基金 跟投：掷铎资本、火山石投资	RISC-V 计算芯片	2022 年	广东 - 广州

30	2025/1/20	鑫精诚	天使轮	近亿元	领投：深创投 跟投：聚合资本、仁智资本	微型压力、称重、六维力、扭力等多样化智能传感器及控制仪表	2021 年	广东 - 深圳
31	2025/1/21	瞻芯电子	C 轮	近 10 亿元	领投：国开制造业转型升级基金 跟投：中金资本、金石投资、芯鑫	碳化硅 (SiC) 功率器件和驱动芯片产品	2017 年	上海市
32	2025/1/21	易星新材料	Pre-A 轮	数千万元	西高投旗下基金	SiC 研磨减薄产品	2016 年	陕西 - 西安
33	2025/1/22	朴烯晶	B 轮	数亿元	领投：国科东方 跟投：大零号湾策源基金、尚研莘工基金、民银国际、红杉中国、上海联和投资、联新资本	高端聚合物材料	2021 年	上海市
34	2025/1/23	佳晟真空技术	A 轮	未披露	诺华资本	半导体高性能真空阀门	2018 年	江苏 - 泰州
35	2025/1/23	微飞半导体	A 轮	未披露	茵联创新	MEMS 测试产品	2023 年	江苏 - 苏州
36	2025/1/23	中科晶盐	A + 轮	未披露	国投创合	高端金属材料及单晶二维材料	2020 年	广东 - 东莞
37	2025/1/26	清科迦合	B 轮	未披露	领投：国投创业基金 跟投：曦晨资本、禾沛投资、丰年资本	半导体液体流量计	2023 年	江苏 - 苏州
38	2025/2/5	智芯科技	D 轮	超 4 亿元	领投：合肥产投资本 跟投：合肥建投、合肥高投	车规处理器、数模混合模拟芯片及 SoC 集成芯片	2020 年	安徽 - 合肥
39	2025/2/6	宇思微电子	Pre-A 轮	未披露	领投：龙鼎投资 跟投：深圳市智慧城市产投基金、启航同心、爱协生科技、卓源亚洲、都宜基金、芯宇嘉华	图像处理与视频传输芯片	2021 年	上海市
40	2025/2/8	奕丞科技	Pre-A++ 轮	数千万元	领投：初芯基金 跟投：合肥领航创投基金	MEMS 探针	2022 年	江苏 - 扬州
41	2025/2/8	贝斯里半导体	天使轮	数千万元	领投：初芯基金	半导体湿法领域核心组件制造	2023 年	山东 - 青岛

42	2025/2/8	纳斯凯	A 轮	近亿元	领投：毅达资本 跟投：高发集团旗下星源资本、广州零部件战略投资	半导体设备关键性 零部件研发生产制 造	2021 年	江苏 - 无锡
43	2025/2/10	芯带科技	A 轮	未披露	中科创星	通信和智能芯片设计	2021 年	江苏 - 无锡
44	2025/2/10	三爱思	天使轮	未披露	初芯基金	半导体晶圆载具	2020 年	江苏 - 苏州
45	2025/2/10	泰矽微	战略融资	数千万元	江苏日盈电子股份有限公司、嘉兴红瓴创业投资合伙企业	数模混合车规 SoC 芯片	2019 年	上海市
46	2025/2/11	矽视科技	A 轮	数亿元	俱成投资、毅达资本、国发创投、相城金控	半导体前道电子束 量检测设备	2021 年	江苏 - 苏州
47	2025/2/11	超睿科技	A1 轮	过亿元	洪泰基金	基于 RISC-V 架构 的高性能 CPU	2021 年	上海市
48	2025/2/12	鲁欧智造	A + 轮	数千万元	领投：中关村发展集团启航投资 跟投：源禾资本	电子热管理	2020 年	山东 - 潍坊
49	2025/2/12	玻色量子	A + 轮	未披露	北京高精尖产业发展投资基金	光量子芯片	2020 年	北京市
50	2025/2/13	迷思科技	A 轮	数千万元	浦东科技投资天使母基金	MEMS 传感器芯片	2020 年	上海市
51	2025/2/13	森木磊石	B 轮	未披露	领投：英诺天使基金 跟投：达益能投资	数字电源控制芯片	2017 年	湖北 - 武汉
52	2025/2/14	探微芯联	天使轮	数千万元	领投：鲲鹏创投 跟投：水木创投、盛景嘉成、创新工场、水木清华校友种子基金	GPU 与 GPU 间的通信协议和交换芯片	2024 年	北京市
53	2025/2/14	象帝先	战略融资	数亿元	安孚科技	GPU	2020 年	重庆市
54	2025/2/17	普照信息	B 轮	7.4 亿元	湖南能源集团、深圳投控制造业转型升级新材料基金、综改试验（深圳）股权投资基金、江丰电子、兴湘资本、湘江国投	掩膜基板材料	2003 年	湖南 - 长沙

55	2025/2/17	瑞为新材	股权融资	未披露	君联资本	封装散热材料与系 统性热管理	2021 年	江苏 - 南京
56	2025/2/17	氮矽科技	战略融资	数千万元	领投：上海矽米企 业管理合伙企业 跟投：南京兰溪高 质股权投资基金	氮化镓产品	2019 年	四川 - 成都
57	2025/2/18	唯琴科技	Pre-A 轮	数千万元	厦门高新投	工业检测设备零部 件	2013 年	福建 - 厦门
58	2025/2/19	芯率智能	B 轮	数千万元	龙鼎投资、元禾璞 华、长沙国控资 本、常垒资本	半导体良率管理和 软件	2006 年	江苏 - 苏州
59	2025/2/21	海创智能	战略融资	数千万元	初芯基金	半导体制造装备	2017 年	山东 - 烟台
60	2025/2/21	高芯众科	D + 轮	未披露	合肥建投资本、永 鑫方舟	半导体真空腔体零 部件制造	2015 年	江苏 - 苏州
61	2025/2/21	派恩杰半 导体	A2、A3 轮	近 5 亿 元	宁波通商基金、宁 波勇诚资管、海半 导体装备材料产业 投资基金、南京创 投、山证创新、坤 泰资本	第三代半导体功率 器件设计	2018 年	浙江 - 宁波
62	2025/2/21	中科海芯	A2 轮	未披露	青岛海发集团、无 锡新洁能股份有限 公司	RISC-V 芯片	2020 年	北京市
63	2025/2/22	思朗科技	D 轮	未披露	宁德时代旗下海泉 资本	MaPU 处理器	2016 年	上海市
64	2025/2/23	龙腾半导 体	股权融资	未披露	西投控股	功率半导体 IDM	2009 年	陕西 - 西安
65	2025/2/24	微崇半导 体	A + 轮	数千万元	金雨茂物、光谷半 导体产投、赛纳资 本	半导体量检测设备	2021 年	北京市
66	2025/2/24	老鹰半导 体	B 轮	超 3 亿 元	拔萃资本、上汽集 团、诺瓦星云、高 瓴创投、财通资 本、唐兴资本	VCSEL 芯片	2018 年	浙江 - 绍兴
67	2025/2/24	中江新材 料	A 轮	近亿元	南京市创投集团、 湖畔资本、微元中 小	陶瓷覆铜板	2012 年	江苏 - 南京
68	2025/2/24	优睿谱	战略投资	未披露	合肥产投投资	半导体前道量测设 备	2021 年	上海市
69	2025/2/24	芯问科技	天使轮	数千万元	熙诚致远、君茂资 本	IC 设计平台	2020 年	上海市

70	2025/2/27	睿普康	A + 轮	未披露	龙鼎投资、合肥产投、国耀资本	手机卫星通信芯片设计	2019 年	安徽 - 合肥
71	2025/2/27	赛昉科技	战略投资	未披露	港投公司	RISC-V 芯片	2018 年	上海市
72	2025/2/28	众硅科技	B + 轮	未披露	毅达资本、达晨财智、温润投资、皖能电力、东证资本	CMP 抛光设备	2018 年	浙江 - 杭州
73	2025/2/28	锐奥光	A + 轮	近亿元	领投：金浦智能 跟投：广州产投、万联广生、南京市创投、毅达资本	光电芯片	2020 年	江苏 - 南京
74	2025/2/28	臻驱科技	E 轮	未披露	领投：国投招商 跟投：广州产投、万联广生、南京市创投、毅达资本	国产功率半导体及新能源汽车驱动解决方案	2017 年	上海市
75	2025/2/28	松应科技	天使轮	数千万元	领投：中科创星 跟投：上海天使会、接力天使、奇绩创坛	实物型 AI 仿真平台	2021 年	北京市
76	2025/2/28	捷扬微电子	B 轮	亿元级	毅达资本、炬芯科技、中兴新集团旗下的同南投资、华强集团旗下的华强创投	短距无线通信 SoC 芯片	2020 年	广东 - 深圳
77	2025/3/3	天硕导航	A 轮	数千万元	深创投	高精度卫星定位芯片	2014 年	江苏 - 苏州
78	2025/3/4	全洋光电	Pre-A 轮	未披露	黄石国资基金	金属掩模版	2021 年	湖北 - 黄石
79	2025/3/5	巽霖科技	Pre-A 轮	数千万元	领投：中关村发展集团启航投资 跟投：北岸产投	陶瓷和玻璃电子基板表面金属化	2023 年	天津市
80	2025/3/5	诺视科技	A 轮	未披露	中信建投资本、富士基金、格力金投	Micro LED 芯片及器件设计	2021 年	江苏 - 苏州
81	2025/3/7	夏禾科技	E 轮	数千万元	毅达资本	OLED 有机发光材料	2017 年	北京市
82	2025/3/7	晶通科技	B 轮	数亿元	力合资本、达安基金、安吉产业基金、辰麓集团	晶圆级扇出型先进封装技术的 Chiplet 方案	2018 年	浙江 - 杭州
83	2025/3/10	华辰芯光	A++ 轮	近 2 亿元	合创资本、衢州工业集团、三维通信	半导体激光芯片	2021 年	浙江 - 杭州

84	2025/3/10	声动微	种子轮	千万级	领投：厦门高新投 跟投：常州启辰、 元科创新基金	测温传感器	2021 年	江苏 - 常州
85	2025/3/11	璧仞科技	D 轮	未披露	上海国投先导人工 智能产业母基金	通用 GPU	2019 年	上海市
86	2025/3/11	灵动佳芯	Pre-A 轮	近亿元	领投：朝希资本、 歌鸿资产 跟投： 艾克斯光谷、零一 创投	触觉传感器	2021 年	江苏 - 苏州
87	2025/3/12	稻润半导 体	战略融资	数千万元	创芯基金	模拟和模数混合芯 片设计	2015 年	上海市
88	2025/3/12	驰芯半导 体	A 轮	近 2 亿 元	领投：兴湘资本 跟投：北京基石创 投、财信金控、农 银国际、昆山高新 创投、橡果资本	UWB 芯片	2020 年	湖南 - 长沙
89	2025/3/13	中科本原	B2 轮	亿元	领投：智慧互联产 业基金 跟投：国 新科创、源创投 资、君戎基金	DSP 芯片	2018 年	山东 - 青岛
90	2025/3/13	昂坤视觉	E 轮	未披露	大基金二期	光学测量与检测设 备	2017 年	北京市
91	2025/3/13	欧冶半导 体	B2 轮	数亿元	国投招商、招商致 远资本、聚合资本	汽车智能化平台级 AI SoC 芯片	2021 年	广东 - 深圳
92	2025/3/14	科鲁斯半 导体	A + 轮	4 亿元	东阳中经芯玑企业 管理合伙企业	封装基板 FCBGA	2023 年	浙江 - 金华
93	2025/3/14	九之星	天使轮	未披露	华大九天	EDA 工具	2024 年	浙江 - 杭州
94	2025/3/17	辰至半导 体	A 轮	未披露	郭彦超（个人）	ASIL - D 级车规 芯片设计	2023 年	北京市
95	2025/3/17	蔚空微纳	Pre A 轮	数千万元	南京市创投集团、 锡创投、麒麟创投	微焦点 X 射线源	2020 年	江苏 - 南京
96	2025/3/18	类比半导 体	战略融资	2 亿元	雅创电子	模拟芯片设计	2018 年	上海市
97	2025/3/19	精测半导 体	B 轮	未披露	大基金二期	半导体前道制程量 检测设备	2018 年	上海市
98	2025/3/19	奥创普科 技	A 轮	未披露	均矽高创	半导体纳米级芯片 AOI 智能检测装备	2020 年	湖南 - 长沙
99	2025/3/19	共进微电 子	A 轮	过亿元	东方富海	传感器芯片封装和 标定测试	2021 年	上海市
100	2025/3/19	致知博约	Pre-A 轮	未披露	倍特基金	电子级胶材	2022 年	陕西 - 咸阳

101	2025/3/20	科瑞尔科技	A + 轮	数千万元	浙创投	半导体封装设备	2014 年	江苏 - 常州
102	2025/3/21	魅杰光电	A + 轮、A++ 轮	近 2 亿元	基石创投、毅达资本、无锡创投、鼎祺基金、鉴桐合源、力合中科、毅晨基金	半导体量检测设备	2015 年	上海市
103	2025/3/21	楚光三维	天使 + 轮	数千万元	元禾原点、光谷产投、常熟国发创投、峰瑞资本	光学精密成像仪器制造	2022 年	湖北 - 武汉
104	2025/3/21	芯动力科技	B1 轮	数千万元	领投：长石资本 跟投：达泰资本、江门长信、硕明	算力芯片	2017 年	广东 - 珠海
105	2025/3/24	星空科技	战略融资	近 3 亿元	领投：广西腾讯创业投资 跟投：国投（广东）科技成果转化基金	光刻机、芯片键合机、纳米压印设备	2021 年	广东 - 广州
106	2025/3/24	苏州国顺激光	A 轮	5000 万元	领投：金沙江联合资本 跟投：苏州天使母基金、常熟吴越天使基金、德同资本	激光器	2021 年	江苏 - 苏州
107	2025/3/24	鑫宇光科技	B 轮	数千万元	同创伟业	光器件	2012 年	河南 - 焦作
108	2025/3/26	上海韬盛电子	C 轮	数亿元	领投：江苏国有企业混合所有制改革基金、安徽中安优选战新贰号投资基金合伙企业 跟投：江苏苏州高端装备产业专项母基金、江苏高毅毅达中小贰号创业投资合伙企业、昆山市玉澄德葆股权投资基金合伙企业	半导体测试	2007 年	上海市
109	2025/3/27	芯弦半导体	Pre-A + 轮	近亿元	领投：元禾重元 跟投：海汇投资、三一创投、曦晨资本、嘉誉资本、苏州工业园区领军创投	“汽车与泛能源”电控专用 “嵌入式处理器” 的集成电路设计	2022 年	江苏 - 苏州



110	2025/3/28	普利姆半 导体	天使轮	数千万元	浙商创投、梅花创 投	精密运动控制仪器	2023 年	浙江 - 湖州
111	2025/3/31	沃镭 智能	Pre-IPO 轮	超亿元	同创伟业、江夏科 投	功率半导体测试及 智能制造整体解决 方案	2008 年	浙江 - 杭州

数据来源：芯潮 IC、公开信息等 MIR DATABANK 整理 www.mirdatabank.com

B. 2025 年 Q2 半导体融资情况

2025 年第二季度，半导体行业延续上行态势，全球半导体销售额突破历史峰值，产业融资热度同步大幅回升。细分领域中，芯片设计以领先的融资案例数与融资金额稳居首位；行业趋势层面，AI 算力需求的爆发式增长成为核心驱动力，直接推动光电芯片赛道加速发展，资本市场对其关注度持续攀升——仅 2025 年以来，该领域已涌现多起亿元级融资事件。

从交易金额来看，本季度亿元级融资共 34 笔，千万元级融资共 38 笔，百万元级融资共 1 笔，其余 49 笔融资未披露金额。

表 6：2025 年 4-6 月半导体行业融资交易金额

统计维度	具体分类	数量 / 笔数
按交易金额划分	亿元级融资	34
	千万元级融资	38
	百万元及融资	1
	未披露金额融资	49

数据来源：芯潮 IC MIR DATABANK 整理 www.mirdatabank.com

从交易轮次来看，主要集 A 轮、B 轮和 Pre-A 轮，分别有 24 笔、14 笔和 10 笔。

表 7：2025 年 4-6 月半导体行业融资交易轮次

统计维度	具体分类	数量 / 笔数
按交易轮次划分	A 轮	23
	B 轮	14
	天使轮	7

数据来源：芯潮 IC MIR DATABANK 整理 www.mirdatabank.com

从交易事件地域分布来看，本季度主要分布在江苏省、广东省和上海市，各自占比为 25.41%、22.95%和 11.48%。



表 8：2025 年 4-6 月半导体行业融资交易地区分布

地域	案例数（起）	占比
江苏	31	25.41%
广东	28	22.95%
上海	14	11.48%
浙江	13	10.65%
北京	12	9.83%
安徽	7	5.74%
福建	5	4.10%
四川	3	2.46%
陕西	3	2.46%
湖北	3	2.46%
湖南	1	0.82%
天津	1	0.82%
重庆	1	0.82%

数据来源：芯潮 IC MIR DATABANK 整理 www.mirdatabank.com

B-1. 2025 年 Q2 半导体行业融资列表

2025 年第二季度半导体行业融资动态频出，从披露数据看，呈现以下关键特征：

本季度半导体行业融资中，**2025 年 4 月 26 日，长控集团**融资额高达 94.21 亿元，成为 Q2 “吸金王”。作为长江存储母公司，其融资受中网投、农银投资、建信投资、交银投资、中银资产、工银资本、谢诺辰途、招银国际资本、上海国有资产经营有限公司、海通创意资本、允泰资本、闻名泉泓基金等多家知名机构追捧，反映出市场对存储芯片赛道及龙头企业的长期看好，也为存储技术迭代、产能扩张提供充足资金支撑，稳固行业在存储领域的竞争力布局。。

2025 年 6 月，专注 VCSEL 激光芯片的纵慧芯光完成数亿元战略融资，IDM 一体化模式契合半导体垂直整合趋势，在光通信、3D sensing 等应用场景驱动下，VCSEL 需求持续增长，融资助力其强化研发与产线，巩固技术壁垒。

2025 年 6 月 30 日，从商汤大芯片部门独立的曦望 Sunrise，聚焦高性能 GPU 与多模态推理芯片，完成 Pre-A 轮融资。AI 算力需求爆发下，国产 GPU 突破海外垄断迫在眉睫，其依托商汤技术积累与三一集团旗下华胥基金、第四范式、游族网络、北京利尔、松禾资本、海通开元等多家知名投资机构的资本加持，有望加速 AI 芯片商业化，填补国内高端算力芯片空白。



融资机构中，既有中网投、农银投资等“国家队”资本，也有三一集团、游族网络等跨界投资者。一方面，产业资本深度绑定半导体核心企业，强化产业链协同（如长控集团融资整合存储产业链资源）；另一方面，跨界资本瞄准 AI、光芯片等前沿赛道，押注技术迭代与场景拓展，推动半导体与 AI、消费电子等行业融合创新。

表 9：2025 年 4-6 月半导体行业融资动态

序号	日期	企业名称	融资轮次	融资金额	主要投资方	主营业务&产品	成立时间	省市
1	2025/4/1	玖熠半导体	A 轮	未披露	锡创投	DFT 工具	2021 年	江苏-无锡
2	2025/4/2	润平电子	战略融资	未披露	毅达资本、中化资本、财通资本	化学机械研磨 (CMP)	2021 年	上海市
3	2025/4/2	美程科技	A 轮	超亿元	湘江国投、兴湘资本、高新创投	先进陶瓷零部件	2010 年	湖南-娄底
4	2025/4/2	盛吉盛智能	A 轮	未披露	未披露	半导体先进封装设备	2022 年	江苏-无锡
5	2025/4/4	笔特科技	B 轮	未披露	德同资本	WIFI 射频、短距和长距通信、园区感传一体的芯片设计	2021 年	广东-深圳
6	2025/4/7	通嘉宏瑞	C 轮	5 亿元	领投：北京市新材料产业投资基金	半导体级真空泵龙头	2012 年	北京市
					跟投：上海瑞力投资、未来资产资本			
7	2025/4/7	丰芯半导体	A 轮	未披露	池州市九华恒创、池州恒创新兴产业基金、池州恒创创新创业投资基金	半导体封装和测试一体服务	2022 年	安徽-池州
8	2025/4/9	芯擎科技	C 轮	1 亿元	千帆企航基金	汽车电子芯片	2018 年	湖北-武汉
9	2025/4/9	爱芯元智	C 轮	超 10 亿元	宁波通商基金、镇海产投、重庆产业投资母基金、重庆两江基	人工智能感知与边缘计算芯片	2019 年	浙江-宁波

					金、元禾璞 华、韦豪创芯			
10	2025/4/9	崇辉半导体	B 轮	未披露	领投：尚顺资 本、广州粤财 跟投：华虹虹 芯、启新源泉	半导体封装材料	2000 年	广东-江门
11	2025/4/9	逻辑比特	天使轮	数千万元	领投：东方嘉 富 跟投：浙江省 科创母基金 (一期)、华 夏恒天、西湖 科创投、藕舫 天使	量子芯片	2022 年	浙江-杭州
12	2025/4/1 1	智仑新材料	A+轮	数千万元	星睿资本	半导体材料	2022 年	陕西-西安
13	2025/4/1 1	紫光国芯	定向增发	2.56 亿 元	中信建投、陕 西科控投资、 西高投、唐兴 资本	存储芯片	2006 年	陕西-西安
14	2025/4/1 1	韬润半导体	D+轮	数千万元	达武创投、福 建电子信息产 投	模拟及模数混合 芯片	2015 年	上海市
15	2025/4/1 4	韵申科技	A 轮	未披露	同创伟业、海 富产业基金、 尚融资本、元 禾原点、蓝天 投资	泛半导体材料设 备	2012 年	上海市
16	2025/4/1 6	锐思智芯	B 轮	未披露	智慧互联产业 基金、浦耀信 晔、中车时代 投资、智宸投 资、毅岭资本	融合视觉传感器	2020 年	广东-深圳
17	2025/4/1 6	芯之纯半导 体	战略融资	未披露	大洋生物	半导体材料	2023 年	浙江-杭州
18	2025/4/1 6	鼎芯光电	B 轮	未披露	杰宜投资；航 源基金；南海 产业投资	VCSEL 激光器	2021 年	江苏-苏州
19	2025/4/1 6	与光科技	A 轮	未披露	金桥鹰石在管 基金、红杉中 国、观新生 元、信熹资本	光谱成像芯片	2020 年	北京市

20	2025/4/1 7	越亚半导体	B 轮	未披露	尚顾资本	无芯 IC（集成电路）封装基板	2006 年	广东-珠海
21	2025/4/1 8	江苏铭芯先进	股权投资	数千万元	中汇金资本	超高频射频毫米波雷达	2025 年	江苏-淮安
22	2025/4/1 8	无锡海古德	E 轮	未披露	国投创业	氮化铝陶瓷基板	2008 年	江苏-无锡
23	2025/4/1 9	飞骧科技	战略融资	数亿元	未披露	射频前端芯片	2015 年	广东-深圳
24	2025/4/1 9	大束科技	A 轮	未披露	华虹虹芯基金	半导体检测设备	2018 年	北京市
25	2025/4/2 1	锌芯钛晶	A+轮	数千万元	紫金港资本	钙钛矿半导体发光材料	2021 年	浙江-温州
26	2025/4/2 1	新川新材料	B+轮	5000 万元	领投：浙创投 跟投：科发资本	MLCC 镍粉	2017 年	浙江-杭州
27	2025/4/2 1	质禾科技	A 轮	未披露	领投：华睿投资 跟投：小苗朗程交大基金、诚美资本	芯片集成光开关	2023 年	浙江-杭州
28	2025/4/2 2	仁芯科技	A 轮	数亿元	陕汽集团、长江汽车电子、移为通信、杭州临空产业基金、杭金投基金、浙江大华投资	车载 SerDes 芯片	2022 年	浙江-杭州
29	2025/4/2 2	华源光电	天使轮	数千万元	韦豪创投、常见投资	固体激光器	2023 年	天津市
30	2025/4/2 2	中科航芯	A+轮	数千万元	未披露	惯性传感器	2021 年	北京市
31	2025/4/2 2	昀冢电子	股权融资	5500 万元	国元股权	中高端片式多层陶瓷电容器	2013 年	江苏-苏州
32	2025/4/2 3	顺为资本	A 轮	未披露	顺为资本	EUV 光刻胶树脂	2016 年	广东-深圳
33	2025/4/2 4	云豹智能	C 轮	未披露	弘卓资本、杭实资管、IDG 资本、萧山资本、杭州资本、中芯聚源、鹏鼎控股、云尖信息	DPU	2020 年	广东-深圳

34	2025/4/25	熹联光芯	C 轮	未披露	武进高新投; 江苏国经资本	硅光芯片	2020 年	江苏-常州
35	2025/4/26	长控集团	战略融资	94.21 亿元	泉泓投资、农银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、央视融媒体基金	存储芯片	2016 年	湖北-武汉
36	2025/4/27	智现未来	A 轮	数亿元	领投: 国投创业、梁溪科创母基金 (博华资本) 跟投: 武汉江夏科投	半导体工程智能系统	2021 年	浙江-无锡
37	2025/4/27	康芯威	B 轮	数千万元	君盛投资	嵌入式存储主控芯片	2018 年	安徽-合肥
38	2025/4/28	福拉特	Pre-A 轮	数千万元	南创投、新港高投、东方产融	半导体显示高端装备	2011 年	江苏-南京
39	2025/4/28	中科爱毕赛思	A+轮	未披露	领投: 中车资本、国科创投 跟投: 成都交投、启泰资本、东海创新投	高性能红外光电探测器	2020 年	江苏-常州
40	2025/4/29	纽姆特	A+轮	超亿元	中金资本、光速光合、张家港产投、德同资本、天堂硅谷、国君创投	硅基负极	2014 年	江苏-苏州
41	2025/4/30	北微传感	B+轮	数千万元	未披露	惯性姿态传感器	2010 年	江苏-无锡
42	2025/4/30	晶引电子	Pre-A 轮	3000 万元	日晟半导体	新型显示及柔性半导体关键器件	2022 年	浙江-丽水
43	2025/5/6	中伟半导体	天使轮	500 万元	厦门高新投	半导体级超高纯金属、高纯化合	2021 年	福建-三明

						物、固态电池电解质材料		
44	2025/5/7	老鹰半导体	B 轮	超 3 亿元	财通资本、上汽集团、诺瓦星云、高瓴创投、拔萃资本、唐兴资本	VCSEL 芯片	2018 年	浙江-绍兴
45	2025/5/7	硅臻芯片	战略融资	数千万元	祥峰投资	集成光子芯片	2020 年	安徽-合肥
46	2025/5/7	科卓半导体	A 轮	7000 万元	未披露	晶圆切割机	2016 年	广东-东莞
47	2025/5/9	腾微芯光	A 轮	未披露	苏高新金控、红杉中国、纽尔利资本、翼檀投资	高速模拟芯片、数字信号处理芯片、光电芯片	2023 年	江苏-苏州
48	2025/5/12	中科芯磁	战略融资	数千万元	初芯控股集团、格力金投、珠海科创投、香洲正菱	高端 FPGA 与可编程异构芯片	2021 年	广东-珠海
49	2025/5/12	衡封新材	Pre-B 轮	数千万元	领投：毅达资本 跟投：临港数科基金、尚研莘工基金、耀途资本	电子级特种酚醛树脂和特种酚醛环氧树脂	2018 年	上海市
50	2025/5/13	星曜半导体	B+轮	过亿元	新微资本、沪硅产业	射频滤波器芯片和射频前端模组	2022 年	浙江-温州
51	2025/5/14	匠岭科技	B+轮	过亿元	领投：启明创投 跟投：元禾璞华、混沌投资、超越创投、临港数科基金、横琴瀚瑞、凯风南翔、冯源资本	半导体量检测设备	2018 年	上海市
52	2025/5/14	鹏钛存储	D 轮	未披露	国开金融、普罗资本、兴晟投资、领新私募基金、中鑫资本、胡杨林资本	全自主企业级 SSD 研发及生产	2016 年	江苏-南京

53	2025/5/15	中科玻声科技	A 轮	近亿元	领投：道禾长期投资、格致资本 跟投：中科创星、溧阳创投	热电半导体 MicroTEC 材料及器件制备	2021 年	江苏-常州
54	2025/5/15	芯耀辉	战略融资	未披露	新华社、国投聚力、上海国投	一站式完整 IP 平台解决方案	2020 年	上海市
55	2025/5/15	跃昉科技	B 轮	超 2 亿元	领投：珠海新质生产力投资基金 跟投：澳门大学发展基金会、新捷利	RISC-VCPU	2020 年	广东-珠海
56	2025/5/16	涌智科技	PreA 轮	未披露	领投：基石创投 跟投：元禾原点、博源资本	专注于智算基础设施技术的芯片设计企业	2024 年	四川-成都
57	2025/5/16	瑜芯半导体	PreA++ 轮	数千万元	黄石市产业发展基金	存储芯片	2019 年	湖北-武汉
58	2025/5/19	英伟芯科技	天使轮	数千万元	中科创星	光电异质集成	2023 年	陕西-西安
59	2025/5/20	巨芯悦	战略融资	未披露	孚腾资本	半导体前道量测与检测设备	2022 年	江苏-无锡
60	2025/5/20	睿芯集成电路	战略融资	未披露	黑橡树资本	大数据处理系统及芯片研发	2020 年	江苏-苏州
61	2025/5/20	普敏半导体	A 轮	未披露	锡创投、无锡国联创投	半导体科技和计算机科技领域开发服务	2021 年	江苏-无锡
62	2025/5/20	鹏武电子	A+轮	数千万元	金雨茂物	集成电路测试设备	2015 年	上海市
63	2025/5/20	银科启瑞	战略融资	近亿元	云泽资本	空间卫星电池、LED 及激光器外延、芯片领域	2021 年	福建-厦门
64	2025/5/21	攻昕科技	B+轮	近亿元	领投：方广资本 跟投：聚和材料、云九资本、KIP 资本	光、热固化功能材料及电子级湿化学品	2019 年	上海市
65	2025/5/21	数字光芯	A+轮	数千万元	领投：广东横琴深合产业投资	MicroLED	2019 年	广东-珠海

					跟投：大丰实业、天际资本、富士基金、方华基金、达莱觅思			
66	2025/5/21	容芯致远	种子轮	数千万元	领投：云岫资本	AGC 智算产品	2024 年	北京市
67	2025/5/21	晶湛电子	A 轮	未披露	水木清华资本	功率半导体芯片设计	2023 年	四川-成都
68	2025/5/22	新施诺	B 轮	未披露	中金资本、盛科创投	半导体自动化物料搬运系统	2022 年	江苏-徐州
69	2025/5/23	寒序科技	天使轮	千万级	彼岸时代、源合资本	磁性计算芯片	2023 年	北京市
70	2025/5/26	光引科技	天使+轮	未披露	中科创星	片上光电集成芯片	2021 年	江苏-徐州
71	2025/5/26	中科四合	战略融资	6000 万元	融溢资本	板级扇出封装技术	2014 年	广东-深圳
72	2025/5/27	创晟半导体	天使+轮	近亿元	华业天成、瑞声战投、讯飞创投、国元创投	高端车规通信芯片	2023 年	广东-深圳
73	2025/5/28	镭神技术	C+轮	数亿元	国风创投领投，电控产投、长江创新投、深创投	半导体设备	2017 年	广东-深圳
74	2025/5/28	行云集成电路	Pre-A 轮	未披露	中博聚力，五源资本，亦联创投，追创创投	GPU	2023 年	北京市
75	2025/5/29	奥创普	A 轮	数千万元	钧犀资本	纳米级 AOI 缺陷检测设备、先进封装微米级高精度贴片机	2024 年	广东-珠海
76	2025/5/29	芯源新材料	C 轮	未披露	小米产投	车规级烧结银/铜	2022 年	广东-深圳
77	2025/5/30	炎黄国芯	B+轮	超亿元	领投：池州产投、梅花创投	宇航等高可靠领域高性能自主可控电源管理芯片	2016 年	北京市
78	2025/6/1	犀里光电	天使轮	数千万元	元禾原点	光引擎系统集成芯片	2025 年	浙江-杭州

79	2025/6/3	合肥欣奕华	B+轮	超3亿元	国开制造业转型升级基金、朝希资本、安徽高新投、国中资本、超高清视频产业投资基金、济南云通	泛半导体高端装备	2013年	安徽-合肥
80	2025/6/3	为旌科技	A2轮	1亿元	领投：君信资本	端侧 AIoC 芯片	2020年	上海市
81	2025/6/4	钧联电子	A轮	近亿元	领投：国元股权 跟投：瑞丞基金、领航创投、聚卓资本	碳化硅 (SiC) 功率模块、电控电驱全链条	2020年	安徽-合肥
82	2025/6/3	龙飞微电子	A轮	未披露	木澜投资、澜起投资	高性能模拟和混合信号芯片	2021年	江苏-无锡
83	2025/6/4	登临科技	股权融资	未披露	园丰资本、元禾控股	通用 GPU	2017年	江苏-苏州
84	2025/6/4	冠华半导体	股权融资	未披露	君桐资本、春鲸资本	半导体前道制程设备中的真空腔体核心零部件	2022年	广东-深圳
85	2025/6/5	景略半导体	D轮	数亿元	国投招商	车载以太网芯片	2009年	上海市
86	2025/6/5	希奥端计算	Pre-A轮	数亿元	领投：毅达资本、南创投 跟投：韦豪创芯	ARM Server CPU 设计	2022年	广东-深圳
87	2025/6/6	纽瑞芯科技	B+轮	未披露	正和颐源、中关村创投、北工投资	无线通信系统芯片	2016年	广东-深圳
88	2025/6/9	智联安科技	D+轮	数亿元	领投：北京市商业航天和低空经济产业投资基金	卫星通信芯片、蜂窝通信芯片	2013年	北京市
89	2025/6/9	埃尔法光电	战略融资	数千万元	安鑫基金	光通信模块	2016年	广东-深圳
90	2025/6/10	华芯科晟	战略融资	未披露	光谷产投	家庭网关芯片	2023年	江苏-南京
91	2025/6/10	固家智能	B轮	数千万元	领投：国中（深圳）三期中小企业发展私募股权投资基金合伙企业	高导热芯片散热材料	2019年	江苏-常州

					业、江苏宜展产业投资有限公司			
92	2025/6/10	先微气体	A+轮	数千万元	领投：国科智能创投、冯源资本 跟投：十月资本、皖西国投	高纯电子特气	2022 年	安徽-合肥
93	2025/6/11	成昱芯联	天使轮	未披露	策源资本、成都高	半导体研发制造	2024 年	四川-成都
94	2025/6/11	熠知电子	战略融资	2.5 亿元	禾盛新材	云端异构 AI 芯片	2017 年	上海市
95	2025/6/12	兴科半导体	B 轮	3.2 亿元	兴森科技	集成电路封装+类载板	2020 年	广东-广州
96	2025/6/12	星思半导体	战略融资	未披露	新经济创投、沛坤盛华创投	全场景天地一体化基带芯片及解决方案	2020 年	上海市
97	2025/6/13	科塔电子	A 轮	未披露	领投：火炬创投	卫星通讯射频芯片	2014 年	福建-厦门
98	2025/6/13	海普瑞	B+轮	未披露	京东方、合肥产投、超越摩尔	国产半导体超纯管阀	2022 年	江苏-常州
99	2025/6/16	中砥半导体	战略融资	未披露	锡创投、顺融资本、新投金石、金投和合基金	磷化铟单晶产品	2024 年	江苏-无锡
100	2025/6/17	中科昊芯	Pre-B+轮	数千万元	华金资本、麦格米特	数字信号处理器 (DSP)	2019 年	北京市
101	2025/6/17	蓝动结密	A+轮	数千万元	领投：弘晖基金、毅达资本	半导体精密部件	2023 年	广东-深圳
102	2025/6/17	极刻光核	B 轮	未披露	好望投资、元航资本、兰璞资本、明势资本	薄膜铌酸锂 IDM 平台研发和应用	2019 年	江苏-苏州
103	2025/6/17	芯视佳	Pre-A 轮	约 6 亿元	领投：创东方、按树资本 跟投：镇江国控、乾成资本	硅基 OLED 微显示	2020 年	广东-深圳
104	2025/6/18	克洛诺斯	B+轮	未披露	国信弘盛	超精密直线电机平台	2015 年	广东-深圳
105	2025/6/18	欧冶半导体	B3 轮	亿元	领投：舜宇产业基金		2021 年	广东-深圳

					跟投：合肥高投、太极华青佩诚	智能汽车第三代E/E架构的 SoC 芯片及解决方案		
106	2025/6/19	原集微科技	种子及Pre-天使轮	数千万元	中科创星、复容投资、司南园科	二维半导体	2025 年	上海市
107	2025/6/19	宏芯科技	B 轮	未披露	华福资本	硅光芯片	2020 年	福建-泉州
108	2025/6/19	长工微电子	C+轮	未披露	深创投、北京国谦投资、东莞金控、君桐资本	混合集成电路设计以及高性能电源芯片	2016 年	广东-东莞
109	2025/6/19	能斯达电子	A 轮	数千万元	领投：苏州苏创空地网联投资基金	柔性微纳传感材料	2013 年	江苏-苏州
					跟投：苏州未来产业天使基金、郑州汉威传感创业投资基金			
110	2025/6/19	埃克斯	C+轮	数亿元	亦庄国投、北京信息产业发展基金	半导体智能制造软件服务	2017 年	北京市
111	2025/6/20	御微半导体	B+轮	未披露	中芯聚源、TCL 创投、中信金石、建信投资、北京先进制造、智能装备基金	集成电路光学量检测系统设计与系统集成	2021 年	安徽-合肥
112	2025/6/21	基本半导体	D++轮	1.5 亿元	中山火炬开发区科创产业母基金、中山金控	碳化硅功率半导体	2016 年	广东-深圳
113	2025/6/23	类比半导体	战略融资	2.98 亿元	雅创电子	数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计	2018 年	上海市
114	2025/6/23	蓝芯算力	Pre-A 轮、Pre-A+轮	数亿元	领投：深创投、南山战新投	RISC-V 芯片设计	2023 年	广东-深圳
					跟投：联想创投、高伟达、金沙江联合、			

					投控东海、银杏谷资本			
115	2025/6/23	詹鼎材料	A 轮	2 亿元	红杉资本、长江创新投、鼎峰投资、八亿时空、趋势资本、厚雪资本	电子氟化液	2022 年	江苏-南通
116	2025/6/24	智汇芯联	战略融资	未披露	华特微电子产业资本	5G-A 蜂窝无源物联网芯片 (AIoT)	2018 年	福建-厦门
117	2025/6/24	有研亿金	战略融资	3 亿元	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	超高纯金属材料	2000 年	北京市
118	2025/6/26	纵慧芯光	战略融资	数亿元	领投：广东东阳光科技控股股份有限公司 跟投：永鑫方舟、耀途资本	国产 VCSEL 器件	2015 年	江苏-常州
119	2025/6/27	希微科技	B 轮	数亿元	领投：上海富瀚微电子股份有限公司 跟投：绍兴柯桥普合创业投资合伙企业、福州创新创业投资合伙企业、瀚联半导体产业基金	Wi-Fi 芯片	2020 年	重庆市
120	2025/6/29	山河光电	股权融资	未披露	亿文创新资本、天津泰达基金	光子芯片产业化	2020 年	江苏-苏州
121	2025/6/30	曦望 Sunrise	Pre-A 轮	近 10 亿元	华胥基金、第四范式、游族网络、北京利尔、松禾资本、海通开元	GPU	2025 年	浙江-杭州
122	2025/6/30	诺视科技	战略融资	未披露	博奥集团	MicroLED 微显示芯片	2021 年	江苏-苏州

数据来源：芯潮 IC、公开信息等 MIR DATABANK 整理 www.mirdatabank.com

C. 2025 年上半年中国半导体企业上市动态梳理

表 10：2025 年上半年中国半导体企业上市动态

公司名称	上市进程节点	上市板块	关键信息详情
矽电股份	3 月 24 日上市	创业板	矽电股份专注半导体专用设备研发、生产与销售，尤其在半导体探针测试技术领域。此次 IPO，矽电股份拟募集资金约 5.45 亿元，用于探针台研发及产业基地建设项目、分选机技术研发项目、营销服务网络升级建设项目以及补充流动资金。
胜科纳米	3 月 25 日上市	科创板	作为行业内知名的半导体第三方检测分析实验室，胜科纳米主要服务于半导体客户的研发环节，可以为半导体全产业链客户提供样品失效分析、材料分析、可靠性分析等专业、高效的检测实验。
屹唐半导体	3 月 11 日注册申请获批	-	屹唐半导体专注前道设备领域，其干法去胶设备、快速热处理设备等已应用于台积电、三星等顶级晶圆厂；
上海超硅半导体	6 月 13 日 IPO 申请获上交所受理	-	3 月 21 日，证监会披露了关于上海超硅首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告，这是集成电路大尺寸硅片企业上海超硅第二次向 IPO 发起冲刺。 6 月 13 日，【上海超硅半导体】科创板 IPO 申请获上交所受理。这是“科创板八条”发布后，又一家未盈利企业科创板 IPO 申请获受理。此次 IPO，上海超硅拟募资 49.65 亿元，将投资于“集成电路用 300 毫米薄层硅外延片扩产项目”“高端半导体硅材料研发项目”和“补充流动资金”。
昂瑞微	3 月 28 日科创板 IPO 获受理		3 月 28 日，射频前端芯片及射频 SoC 芯片设计企业昂瑞微科创板 IPO 获受理，成为 2025 年首家采用科创板第五套标准申报的半导体企业，为科创板首家受理的未盈利射频芯片企业；
武汉新芯	3 月 31 日 IPO 审核状态更新为已问询	-	武汉新芯成立于 2006 年，是国内领先的半导体特色工艺晶圆代工企业，

			业务聚焦于特色存储、数模混合和三维集成领域；
瀚天天成	4 月 8 日向港交所递交上市申请	-	根据公开数据显示，自 2023 年以来，按年销售片数计算，瀚天天成是全球最大的碳化硅外延供应商，2024 年的市场份额超过 30%。
奕斯伟	5 月 30 日向港交所递交招股书	-	按 2024 年相关收入计算，奕斯伟是国内第四大 RISC-V（基于精简指令集计算原理的开放指令集架构）主控解决方案供应商以及国内最大的 RISC-V 全定制解决方案供应商，被认为有望成为“RISC-V 第一股”。
兆芯集成	6 月 17 日提交科创板 IPO 申请	-	国产 x86 处理器厂商，拟发行不超 38,286.77 万股，拟募资 41.69 亿元
芯迈半导体	6 月 30 日向港交所主板递交上市申请	-	芯迈半导体成立于 2019 年，总部位于杭州滨江区，是一家功率半导体公司，通过自有工艺技术提供高效的电源管理解决方案。

注:以上仅展示部分内容

数据来源：芯潮 IC、公开信息等 MIR DATABANK 整理 www.mirdatabank.com